



(19)  
Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 10 2006 015 377 A1** 2007.10.11

(12)

## Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2006 015 377.4**

(22) Anmeldetag: **03.04.2006**

(43) Offenlegungstag: **11.10.2007**

(51) Int Cl.<sup>8</sup>: **H01L 25/075** (2006.01)

**H01L 23/498** (2006.01)

**G21K 5/04** (2006.01)

**A61C 5/04** (2006.01)

**C08J 3/28** (2006.01)

(71) Anmelder:  
**Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein, LI**

(74) Vertreter:  
**PAe Splanemann Reitzner Baronetzky  
Westendorp, 80469 München**

(72) Erfinder:  
**Plank, Wolfgang, Rankweil, AT; Senn, Bruno,  
Buchs, CH**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:

**DE10 2005 028176 A1**

**DE 200 07 730 U1**

**US 63 31 111 B1**

**WO 2005/0 67 063 A1**

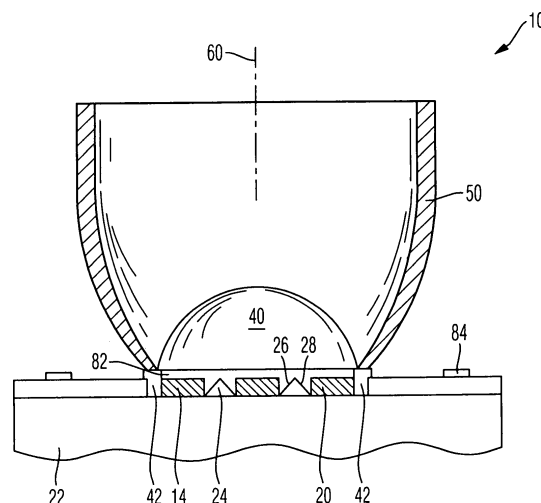
**JP 2001-203 395 A (PAJ);**

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Halbleiter-Strahlungsquelle sowie Lichthärtgerät**

(57) Zusammenfassung: Eine Halbleiter-Strahlungsquelle weist einen Basiskörper auf, auf dem mindestens zwei LED-Chips unmittelbar gelagert und in Wärmeleitverbindung auf dem Basiskörper angebracht sind. Mindestens eine Printplatte ist auf dem Basiskörper gelagert, die sich von den zentral angeordneten LED-Chips nach außen, insbesondere zum Umfangsbereich des Basiskörpers, erstreckt und insbesondere in Freiflächen hineinragt, die sich seitlich neben oder zwischen den Chips erstrecken.



## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft eine Halbleiter-Strahlungsquelle, gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

**[0002]** Bei einer derartigen Halbleiter-Strahlungsquelle ist es bereits vorgeschlagen worden, mindestens zwei LED-Chips zentral auf einem Kühlkörper zu lagern und über eine gemeinsame Sammellinse die Lichtabgabe der LED-Chips zu bündeln. Die Lichtabgabe ist besonders effizient, wenn die LED-Chips eng benachbart dem Brennpunkt der Linse angeordnet sind. Durch eine derartige eng benachbarte Anordnung wird neben der hohen Lichtleistung eine erhebliche Wärmeleistung dort erzeugt. Hierzu ist es längst bekannt, Kühlkörper einzusetzen, um die Wärmeleistung abzuführen. Für die Lichtausbeute ist es entscheidend, dass hier eine gute Kühlung vorgenommen, um dem Betriebstemperaturbereich der LED-Chips nicht zu überschreiten.

**[0003]** Gerade energiereiche LED-Chips müssen für ein zuverlässiges Funktionieren abgedichtet aufbewahrt werden. Um dies zu erreichen, ist es seit langem bekannt, die LED-Chip in Kunststoffkörpern zu vergießen. Dies bedingt jedoch eine vorgegebene Form eines Linsenkörpers. In vielen Fällen wäre es wünschenswert, anstelle der üblichen Vergußmasse ein Material mit höherem Brechungsindex zu verwenden, so dass eine separate Linse erwünscht ist. Beispielsweise kann eine derartige Linse aus einem hochbrechendem Kunststoff oder Glas bestehen. Diese Linse sollte jedoch andererseits, nachdem es sich um ein optisches Präzisionsbauteil handelt, nicht zu großen Wärmeschwankungen unterworfen werden, damit sie sich nicht verformt oder eintrübt.

**[0004]** Um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten, ist es bekannt geworden, den Raum zwischen Linse und Chip über eine Flüssigkeit zu füllen. Gegenüber einer Luftbefüllung ist hiermit eine wesentlich verbesserte Wärmeableitung möglich. Hintergrund ist, dass die Flüssigkeit aufgrund von Konvektionen zwischen der vergleichsweise kühlen Kühlkörperoberfläche und den LED-Chips strömt, so dass ein Wärmeaustausch erzielt wird.

**[0005]** Bei einer Flüssigkeitsfüllung muss jedoch Sorge getragen werden, dass eine sichere Abdichtung für den Raum zwischen Linse und Chip gewährleistet ist. Diese Abdichtung ist vergleichsweise aufwändig, denn typischerweise muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Flüssigkeit durch die Erwärmung ausdehnt. Die entstehenden Probleme sind umso größer, je größer die von den LED-Chips erzeugte Verlustwärme ist, während andererseits gerade Hochleistungschips recht viel Wärmestrahlung abgeben.

**[0006]** Um die Wärme besser ableiten zu können, ist es bereits vorgeschlagen worden, eine Vielzahl von LED-Chips verteilt anzubringen. Zwar lässt sich auch hierdurch eine recht hohe Gesamt-Lichtleistung bereitstellen. Die Bündelung des Lichtstrahls ist – gerade bei Einleitung in einen Lichtleiter – jedoch erheblich aufwändiger, und es ist auch erforderlich, eine Vielzahl von einzelnen LED-Chips – je mit den entsprechenden Ansprüchen – zu montieren. Die Einzelchip-Ausfallwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Chips ausfällt, ist wesentlich höher und die Konstruktion wird insgesamt wesentlich schwerer, was gerade bei Handgeräten unerwünscht ist.

**[0007]** Gerade bei Handgeräten ist der zur Verfügung stehende Raum für die Bereitstellung der LED-Chips ausgesprochen begrenzt. Andererseits wäre es wünschenswert, ausreichend Platz für die Anschlüsse und gegebenenfalls auch für Vorwiderstände für den Abgleich bzw. die Kalibrierung der LED-Chips bereitzustellen, aber dennoch ist eine gute Wärmeableitung über den Basiskörper, hingegen eine Wärmeabschirmung nach vorne hin zu sorgen.

**[0008]** Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine Halbleiter-Strahlungsquelle gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 zu schaffen, die hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der Lichteffizienz und der Verlustleistungsabführung verbessert ist, ohne dass die Gefahr bestünde, dass vor der Halbleiter-Strahlungsquelle angeordnete Bauteile stark erwärmt werden.

**[0009]** Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

**[0010]** Erfindungsgemäß besonders günstig ist es, wenn die LED-Chips in dichter Packung, also angrenzend aneinander – gegebenenfalls unter Zwischenschaltung von sehr kompakten Reflektorelementen – in einem zentralen Bereich des Basiskörpers angeordnet sind. Hierunter ist ein mittlerer Bereich des Basiskörpers zu verstehen, der sich beispielsweise über etwa das mittlere Drittel oder weniger, beispielsweise auch über das mittlere Fünftel, des Basiskörpers erstreckt. Dies erlaubt zunächst, ausreichend Platz für Leiterbahnen für die stabile und temperaturfeste mechanische Anschlußbereitstellung, sowie gegebenenfalls für Vorwiderstände, zu belassen. Zudem ermöglicht diese zentrale Anordnung, nahezu den gesamten Bereich, beispielsweise 90% der Fläche, des Basiskörpers mit einer Printplatte zu versehen. Die Printplatte hat hier die Doppelfunktion, die Anschlussleitungen möglichst eng an die LED-Chips heranzuführen, um geeignete Anschlussflächen, insbesondere für Bondverbindungen, bereitzustellen. Zudem dient sie der Wärmedämmung und schützt

damit die thermisch empfindliche Optik vor der Anstrahlung des vergleichsweise heißen Basiskörpers, der so besonders effizient für die Ableitung der Wärme der LED-Chips benutzt werden kann. Die Printplatte wirkt insofern wie eine Art Mantel und deckt praktisch die gesamte Fläche des Basiskörpers, abgesehen von der Fläche, die von den LED-Chips eingenommen wird, so wie gegebenenfalls von den sehr kleinen Reflektorelementen, ab.

**[0011]** Die Reflektorelemente können so klein sein, dass jedes Reflektorelement beispielsweise lediglich ein Zehntel der Fläche jedes LED-Chips einnimmt, wobei die LED-Chips ohnehin sehr klein sind. Dies ermöglicht überraschend einen besonders guten Schutz der Linse und weiterer empfindlicher optischer Bauteile, und zwar überraschend auch gegenüber dezentral aufgebauten Chips, bei denen insofern mehrere punktförmige Wärmequellen verteilt strahlen.

**[0012]** Überraschend hat sich die in besonders günstiger Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Halbleiter-Strahlungsquelle vorgesehene fingerförmige Teilabdeckung von LED-Chips radial belegten Bereich als besonders wirksam herausgestellt. Hierdurch lassen sich einerseits die Anschlussflächen für das Bonden besonders nahe an die Chips heranzuführen, aber andererseits ergibt sich auch eine besonders gute Wärmedämmung an sehr heißen Bereichen des Basiskörpers.

**[0013]** Eine kreuzförmige oder sternförmige Anordnung der LED-Chips begünstigt diese bevorzugte Ausgestaltung, bei der dann die seitlichen Freiflächen, also die Flächen, die sich bei Betrachtung von der Seite neben einem äußeren LED-Chip erstrecken, vollständig oder zumindest im Wesentlichen vollständig von der Printplatte abgedeckt sind. Bei quadratischen LED-Chips ist eine kreuzweise Anordnung der Chips bevorzugt, so dass sich insgesamt vier seitliche Freiflächen – je zwischen den Schenkeln des Kreuzes – erstrecken, aber auch eine sternförmige Anordnung, beispielsweise eines Sterns mit drei, fünf oder sechs Schenkeln erlaubt die Bereitstellung seitlicher Freiflächen, die dann von einer Printplatte abgedeckt werden.

**[0014]** Diese Ausgestaltung steht der Kompaktpackung mit guter Fokussierbarkeit der abgegebenen Lichtstrahlung mit einer einzigen Linse nicht entgegen. Besonders günstig ist es in diesem Zusammenhang, wenn die Linse über einen Abstandshalter abgestützt ist, der seinerseits auf der Printplatte gelagert ist, so dass auch der Abstandshalter selbst sich auf einem geringeren Temperaturniveau befindet.

**[0015]** Besonders günstig ist es in diesem Zusammenhang, wenn die LED-Chips so dicht aneinander angrenzen, dass die Breite zwischen ihnen weniger

als ein Fünftel, insbesondere etwa ein Zehntel, des Durchmessers jedes LED-Chips beträgt.

**[0016]** Erfindungsgemäß besonders günstig ist es auch, wenn durch ein eng an einen Einzelchip angrenzendes Reflektorelement, das in seiner Höhe auf die Höhe des LED-Chips beschränkt sein kann, das dort austretende Strahlungsmaximum ausgenutzt und nach vorne reflektiert werden kann. Dies erlaubt es auch, einen Abstand zwischen einem sich vor den LED-Chips erstreckenden Parabol-Reflektor oder Reflektorkegel in Richtung der optischen Achse vorzunehmen und insofern auch die Einleitung der Wärmestrahlung auch auf den optischen Reflektor zu reduzieren, ohne dass Emissionsstrahlung verloren ginge. Bevorzugt ist es in diesem Zusammenhang, wenn die abgegebene Lichtstrahlung zunächst die vor den LED-Chips angeordnete gemeinsame Abdecklinse durchtritt und erst dann auf den Parabol-Reflektor fallen kann. Dies erlaubt es, den größten Teil der abgegebenen Lichtstrahlung bereits vorab zu bündeln und zu fokussieren, so dass auch eine etwaige Verschmutzung des Reflektors sich weniger stark auswirken würde.

**[0017]** In erfindungsgemäß besonders günstiger Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass ein für die Linse vor den LED-Chips vorgesehener Abstandshalter im Wesentlichen ringförmig ausgestaltet ist, wobei sich die Leiterbahnen der Printplatte unter dem Abstandshalter hindurch erstrecken. Dies ermöglicht einerseits ein einfaches Bonden, wobei die Bonddrähte nach Anbringung des Abstandshalters und der Linse gut geschützt sind, aber andererseits eine leichte Kontaktierung nach außen.

**[0018]** Die erfindungsgemäße Printplatte kann aus einem beliebigen geeigneten wärmedämmenden Material bestehen, beispielsweise aus Epoxidharz, aber auch aus einem anderen hierfür geeigneten Kunststoff oder auch aus Keramik.

**[0019]** Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Printplatte in Freiflächen hineinragt, die sich seitlich neben den Chips erstrecken.

**[0020]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Printplatte bis neben die Chips verläuft, jedoch nicht zwischen Chips und optischer Achse der Strahlungsquelle.

**[0021]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass ein erster LED-Chip in einer optischen Achse angeordnet ist und eine Mehrzahl von mehreren LED-Chips, insbesondere symmetrisch zueinander und den LED-Chip nach der Art eines Kreuzes oder Sternes umgebend, radial außerhalb des ersten LED-Chips angeordnet sind.

**[0022]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass vier weitere LED-Chips den ersten LED-Chip umgeben.

**[0023]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die LED-Chips in dem zentralen Bereich des Basiskörpers einander benachbart, also ohne Printplatte zwischen ihnen, angeordnet sind.

**[0024]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Printplatte die LED-Chips umgibt.

**[0025]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die LED-Chips und die Printplatte im Wesentlichen die gleiche Höhe aufweisen.

**[0026]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass insbesondere über Bondverbindungen Anschlußflächen von Leiterbahnen der Printplatte mit den LED-Chips verbunden sind.

**[0027]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die LED-Chips, ggf. über einen thermisch leitfähigen Kleber, unmittelbar auf dem Basiskörper gelagert sind und die Printplatte auf dem Basiskörper insbesondere aufgeklebt ist.

**[0028]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Printplatte eine Epoxidharzbasis aufweist und wenigstens auf einer Seite mindestens eine Leiterbahn aufweist und insbesondere mit Kupfer beschichtet sowie durchkontaktiert ist.

**[0029]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die LED-Chips auf einem zentralen Vorsprung des Basiskörpers angeordnet sind, dessen Höhe im Wesentlichen der Höhe der Printplatte entspricht.

**[0030]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass mindestens zwischen zwei einander benachbarten LED-Chips ein Reflektorelement angeordnet ist, das sich an dem Basiskörper, und/oder der Printplatte und/oder den LED-Chips, insbesondere auch an dem Basiskörper, abstützt.

**[0031]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass ein sich zwischen zwei LED-Chips erstreckendes Reflektorelement zwei im Wesentlichen schräg verlaufende Reflexionsflächen aufweist, wobei jede Reflexionsfläche aus dem benachbarten LED-Chip stammende Strahlung reflektiert.

**[0032]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Reflexionsflächen in Richtung der optischen Achse betrachtet sich im We-

sentlichen entsprechend der Höhe der Printplatte erstrecken oder die Printplatte überragen.

**[0033]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass Reflexionsflächen leicht konkav oder parabolisch ausgestaltet sind und dass das Reflektorelement einen im Wesentlichen dreieckigen Querschnitt, insbesondere im Wesentlichen eines gleichschenkligen Dreiecks, aufweist.

**[0034]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass mehrere Reflektorelemente unter Bildung eines Gitterreflektors miteinander verbunden sind.

**[0035]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die LED-Chips in dem Gitterreflektor aufgenommen sind und dass sich der Gitterreflektor an dem Basiskörper und/oder der Printplatte und/oder den LED-Chips abstützt.

**[0036]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass sich Reflektorelemente zwischen den seitlichen Freiflächen und den LED-Chips erstrecken und dort insbesondere die LED-Chips abstützen.

**[0037]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass sich zwischen LED-Chips, insbesondere zwischen äußeren LED-Chips, und der Printplatte Strahlungsabsorber erstrecken, die insbesondere mit dem Basiskörper in Wärmeleitverbindungen miteinander verbunden sind.

**[0038]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Strahlungsabsorber zugleich wärmedämmend ausgebildet sind und insbesondere aus Keramik bestehen.

**[0039]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Strahlungsabsorber sich mindestens über die Breite der LED-Chips erstrecken und insbesondere eine größere Höhe als die LED-Chips aufweisen, bevorzugt etwa die 1,5 bis 5-fache Höhe und besonders bevorzugt etwa die zweifache Höhe der LED-Chips.

**[0040]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass eine Abdecklinse im Strahlengang nach den LED-Chips angeordnet ist und ein Abstandshalter für diese im Wesentlichen rohr- oder ringförmig ausgebildet ist, und dass der Abstandshalter mindestens teilweise auf der Printplatte und/oder dem Basiskörper abgestützt ist.

**[0041]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass mindestens eine Leiterbahn der Printplatte unter einem Abstandshalter hindurch verläuft und insbesondere von außerhalb des Abstandshalters nach innerhalb des Abstandshalters

verläuft.

**[0042]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass sich zwischen den LED-Chips, dem Abstandshalter und der Abdecklinse ein geschlossener Raum erstreckt, der eine durchsichtige oder durchscheinende, flüssige oder gelförmige Substanz, insbesondere Silikongel oder eine Verfüßmasse, aufweist.

**[0043]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die Substanz Phosphorpartikel aufweist.

**[0044]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass im Strahlengang nach einer Abdecklinse eine Sammellinse angeordnet ist, deren Durchmesser insbesondere größer als der Durchmesser der Abdecklinse ist.

**[0045]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass von den LED-Chips beabstandet vor diesen, also im Strahlengang nach diesen, und/oder insbesondere auch im Strahlengang nach einer Abdecklinse, ein Reflektor angeordnet ist.

**[0046]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass im Strahlengang nach dem Reflektor ein Lichtleiter angeordnet ist.

**[0047]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass auf der Printplatte, außerhalb des Abstandshalters insbesondere abgleichbare Vorwiderstände angeordnet sind, die für die Abgleichung frei zugänglich sind.

**[0048]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass der erste LED-Chip und die weiteren LED-Chips Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen ausstrahlen, insbesondere einerseits mit 400 bis 430 nm und andererseits mit 450 bis 480 nm.

**[0049]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass der erste Chip und die weiteren Chips gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten einschaltbar und ausschaltbar sind.

**[0050]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass der erste LED-Chip Licht mit 400 bis 430 nm und die weiteren LED-Chips Licht mit 450 bis 480 nm ausstrahlen.

**[0051]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass das Lichthärtgerät als Handgerät mit einem Griff ausgebildet ist.

**[0052]** In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass das Lichthärtgerät ein Gehäuse aufweist, an dem die Sammellinse abgestützt ist.

**[0053]** Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung.

**[0054]** Es zeigen:

**[0055]** [Fig. 1](#) Eine schematische Ansicht eines Details einer erfindungsgemäßen Halbleiter-Strahlungsquelle;

**[0056]** [Fig. 2](#) eine Draufsicht auf ein weiteres Detail einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Halbleiter-Strahlungsquelle;

**[0057]** [Fig. 3](#) einen Schnitt durch eine Halbleiter-Strahlungsquelle;

**[0058]** [Fig. 4](#) einen Schnitt durch eine weitere Ausführungsform einer Halbleiter-Strahlungsquelle;

**[0059]** [Fig. 5](#) eine Draufsicht auf die Halbleiter-Strahlungsquelle in der Ausführungsform gemäß [Fig. 4](#);

**[0060]** [Fig. 6](#) einen Schnitt durch die erfindungsgemäße Halbleiter-Strahlungsquelle in einer weiteren Ausführungsform;

**[0061]** [Fig. 7](#) eine Draufsicht auf die Ausführungsform gemäß [Fig. 6](#); und

**[0062]** [Fig. 8](#) eine Draufsicht auf einen Teils einer erfindungsgemäßen Strahlungsquelle; und

**[0063]** [Fig. 9](#) einen Schnitt durch die Ausführungsform gemäß [Fig. 8](#).

**[0064]** Die in [Fig. 1](#) teilweise dargestellte Halbleiter-Strahlungsquelle **10** weist eine Mehrzahl von LED-Chips auf, in dem dargestellten Ausführungsbeispiel einen mittig angeordneten Chip **12** und vier je sich entlang seiner Seitenkanten erstreckende Chips **14**, **16**, **18** und **20**. Die Chips sind auf einem Basiskörper **22** angebracht, der aus Metall besteht und zugleich als Montagebasis und als Kühlkörper. Der Basiskörper besteht bevorzugt wenigstens teilweise aus Kupfer und/oder ist wenigstens teilweise mit Gold oder Nickel-Gold beschichtet. Die Aufbringung erfolgt mit einem geringen Wärmewiderstand zwischen den Chips und dem Basiskörper **22**, so dass auch eine hohe Wärmeleistung abführbar ist.

**[0065]** Zwischen dem mittigen Chip **12** und den benachbarten Chips **14** bis **20** ist je ein Reflektorelement **24** angeordnet, das in der Seitenansicht einen im Wesentlichen dachförmigen Aufbau hat. Das Reflektorelement **24** erstreckt sich angrenzend an die je benachbarten Seitenflächen der LED-Chips **18** und **12** und dient der Reflektion der an über die Seitenflä-

chen austretenden Strahlung der LED-Chips. Die Reflexionsflächen **26** und **28** erstrecken sich etwa im Winkel von  $45^\circ$  gegenüber der Oberfläche des Basiskörpers **22**, so dass schräg aus dem Chip **12** bzw. **18** austretende Strahlung schräg nach vorne reflektiert wird. Die Reflexion folgt bekanntermaßen dem Grundsatz Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel, so dass die betreffende Strahlung regelmäßig schräg nach vorne fällt. Vor den LED-Chips ist eine Abdecklinse **40** angeordnet, die die Strahlung bündelt und vor der Abdecklinse ein Reflektor **50**, der noch seitlich austretende Strahlung weiter fokussiert, damit sie einem noch weiter vor den LED-Chips angeordneten Eintrittsende eines Lichtleiters zugeleitet werden kann.

**[0066]** Es versteht sich, dass der Schrägstellungswinkel der Reflexionsflächen **26** und **28** in weiten Bereichen an die Erfordernisse anpassbar ist. Eine stärkere Fokussierung für die Hauptstrahlung ergibt sich durch einen Schrägstellungswinkel von beispielsweise  $60^\circ$  gegenüber der Oberfläche des Basiskörpers **22**, wobei dann gewisse Anteile der austretenden Strahlung rückreflektiert werden, also über die optische Achse der Abdecklinse hinaus auf die gegenüberliegende Seite reflektiert werden, was im Grunde nicht erwünscht ist.

**[0067]** In den dargestellten Ausführungsbeispielen ist die Höhe jedes Reflektorelements wesentlich höher als die Höhe eines Chips. Es versteht sich, dass auch diese Höhe in weiten Bereichen an die Erfordernisse anpassbar ist, beispielsweise von dem einfachen bis zum dreifachen oder sogar fünffachen der Höhe des Chips betragen kann.

**[0068]** Die Reflektorelemente **24** wirken zugleich auch als Abstandhalter zwischen den LED-Chips. Sie können auch an allen vier Seitenkanten beispielsweise des Chips **12** vorgesehen sein; auch eine Gitterstruktur gemäß dem Gitterreflektor **30**, wie sie aus [Fig. 2](#) ersichtlich ist, ist besonders günstig, nachdem hierdurch auch die Montage der Chips vereinfacht werden kann. Die Reflektorelemente **24** sind bei dieser Lösung zu dem Gitterreflektor **30** zusammengefasst. Jeder Steg des Gitters weist daher den entsprechenden dachförmigen Querschnitt auf, also im Wesentlichen den Querschnitt eines gleichschenkligen Dreiecks, je von der Seite betrachtet, und die Stege erstrecken sich kreuzweise zueinander, wie es aus [Fig. 2](#) ersichtlich ist. Hierdurch sind Freiflächen belassen, wobei in der Ausgestaltung gemäß [Fig. 2](#) in den Freiflächen **34a**, **34b**, **34c**, **34d** und **34e** je ein LED-Chip aufgenommen ist – entsprechend den LED-Chips **12** bis **20** aus [Fig. 1](#) –, während die Freiflächen **36a**, **36b**, **36c** und **36d**, die sich seitlich neben den Chips befinden, frei auch von Chips sind. Es ist bevorzugt, dass dort die Printplatte hineinragt, die der Bereitstellung von Anschlussflächen für die LED-Chips dient. Diese bevorzugte Ausgestaltung

erlaubt es, die Printplatte einerseits recht nahe an die Chips heranzuführen, was für das Bonden günstig ist, aber andererseits eine kompakte Chipanordnung zu gewährleisten, die aus optischen Gründen günstig ist.

**[0069]** Es versteht sich, dass im Grunde an die Freiflächen **36a** bis **36d** angrenzend keine Schrägflächen des Reflektorelements **24** vorgesehen sein müssen, denn dort wird keine Strahlung abgegeben. Insofern ist es ausreichend, wenn dort die Breite der Gitterstruktur **30** halbiert ist, also sich lediglich einseitig Schrägflächen je zu den benachbarten Chip hin erstrecken. Aus Gründen der einfacheren Fertigung und auch aus Gründen der besseren Stabilität der Finger des Gitterreflektors **30** kann dennoch eine je zugehörige Reflexionsfläche vorgesehen sein. Beispielsweise kann jeder LED-Chip eine Kantenlänge von 1,5 mm aufweisen, so dass die Breite jedes Fingers **38** der Gitterstruktur beispielsweise 0,5 mm betragen kann. Eine Gitterstruktur mit Fingerbreiten von 0,5 mm lässt sich aber wesentlich besser handhaben als eine Gitterstruktur einer Fingerbreite von 0,25 mm.

**[0070]** Erfindungsgemäß besonders günstig ist es, dass der Abstand zwischen den einzelnen LED-Chips weniger als  $1/5$ , insbesondere etwa  $1/10$ , des Durchmessers jedes LED-Chips beträgt.

**[0071]** Es versteht sich, dass die genauen Abmessungen der Halbleiter-Strahlungsquelle **10** in weiten Bereichen an die Erfordernisse anpassbar sind. Besonders günstig ist es, wenn die Gesamtbreite der Chipanordnung der erfindungsgemäßen Halbleiter-Strahlungsquelle **10**, die Erstreckung von der Außenkante des Chips **18** zur Außenkante des Chips **16**, oder die Erstreckung von der Außenkante des Chips **12** bis zur Außenkante des Chips **20**, weniger als 8 mm, insbesondere weniger als 6 mm und bevorzugt etwa 5 mm beträgt, so dass einerseits eine zentrale Anordnung der LED-Chipanordnung auf dem Basiskörper möglich ist, aber andererseits dennoch eine günstige Wärmeableitung möglich ist. Bei dieser Dimensionierung kann der Basiskörper beispielsweise eine Breite von etwa 1,5 cm und eine Länge von etwa 2,5 cm aufweisen und in weiter unten liegenden Bereichen in an sich bekannter Weise mit Kühlrippen versehen sein.

**[0072]** Eine modifizierte Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Halbleiter-Strahlungsquelle **10** ist aus [Fig. 3](#) ersichtlich. Dort sind ebenfalls fünf LED-Chips kreuzweise angeordnet, ähnlich wie es bei den Ausführungsformen gemäß [Fig. 1](#) und [Fig. 2](#) vorgesehen ist. Zwischen ihnen erstreckt sich eine Gitterstruktur **30** mit Reflektorelementen **24**, deren Höhe praktisch der Höhe der LED-Chips entspricht. Unmittelbar hieran angrenzend ist eine Abdecklinse **40** vorgesehen. Unter unmittelbar angrenzend ist hier

zu verstehen, dass die Abdecklinse **40** auf den Oberkanten der Reflektorelemente **24** aufliegen kann, oder einem ganz geringen Abstand von beispielsweise 0,1 bis 1 mm sich oberhalb der LED-Chips erstrecken kann.

**[0073]** Die Abdecklinse **40** ist über einen Abstandshalter **42** abgestützt. Der Abstandshalter **42** weist eine Innenschulter **44** auf, die sich genau zum Umfang der Abdecklinse **40** erstreckt, diese seitlich abstützt und umgreift.

**[0074]** Der Abstandshalter **42** ist hauptsächlich auf einer Printplatte **46** abgestützt, wobei im Bereich eines Zapfens **48** die Abstützung zusätzlich auf dem Basiskörper **22** erfolgt. Die Printplatte **46** erstreckt sich seitlich bis zu den äußeren LED-Chips **14** und **20** hin – abgesehen von dem Zapfen **48**, der in [Fig. 3](#) im Schnitt dargestellt ist – erstreckt sich jedoch noch weiter radial einwärts neben den Chips **14** und **20**, nämlich in die Freiflächen **36a**, **36b**, **36c** und **36d** hinein, so dass Teile der Printplatte sich je zwischen den äußeren LED-Chips, also beispielsweise zwischen dem Chip **14** und dem Chip **16**, erstrecken. Gerade dort, also im Bereich der Freiflächen **36a** bis **36d**, sind Anschlußflächen ausgebildet, die aus [Fig. 3](#) nicht ersichtlich sind.

**[0075]** Die Kontaktierung erfolgt bevorzugt so, dass der Basiskörper **22** als Massekörper dient, während Leiterbahnen zu den Chips **12** bis **20** hingeführt sind, die sich oben auf der Printplatte **46** erstrecken und den Anschluß sicherstellen.

**[0076]** Oberhalb des Abstandshalters **46** erstreckt sich ein Reflektor **50**, der in an sich bekannter Weise eine parabolische Oberfläche aufweist. Er schließt sich an die Vorderseite der Abdecklinse **40** an. Durch diese Zwischenschaltung ist er zusätzlich thermisch getrennt von den heißen LED-Chips **12** bis **20** und von dem ebenfalls recht warmen Basiskörper **22**, so dass er nicht zur Eintrüben neigt, auch wenn preisgünstiges Kunststoffmaterial eingesetzt wird.

**[0077]** Von dem Reflektorelement etwas beabstandet erstreckt sich dieses überlappend eine Sammellinse **52**, die an einer Innenschulter in dem Gehäuse **54** gelagert ist. Das Gehäuse **54** nimmt wiederum den Basiskörper **22** auf, so dass insofern eine feste räumliche Zuordnung zwischen dem Reflektor **50** und der Sammellinse **52** gegeben ist.

**[0078]** Eine modifizierte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Strahlungsquelle ist aus [Fig. 4](#) ersichtlich. Bei dieser Lösung ist eine Mehrzahl von LED-Chips **12**, **14** kompakt und zentral auf dem Basiskörper **22** angeordnet. Wie auch bei den Ausführungsformen gemäß [Fig. 1](#) bis [Fig. 3](#) sind die LED-Chips eng benachbart angeordnet, wobei höchstens ein Reflektorelement sich zwischen ihnen

erstreckt und – in dem dargestellten Ausführungsbeispiel – kein Reflektorelement vorgesehen ist.

**[0079]** Erfindungsgemäß besonders günstig ist es, dass sich zwischen der optischen Achse **60** und den Chips keine Printplatte erstreckt, sondern dass insofern eine enge Anordnung vorgesehen ist, während sich seitlich eine Printplatte in den Bereich der LED-Chips hinein erstrecken kann. Bei der Ausführungsform gemäß den [Fig. 4](#) und [Fig. 5](#) ist die Printplatte **46** deutlich außerhalb der Chipanordnung vorgesehen und umgibt diese kreisringförmig, wie es aus [Fig. 5](#) ersichtlich ist. Sie deckt auch den Basiskörper **22** praktisch auf seiner gesamten Oberfläche ab, so dass eine gute Wärmedämmung nach vorne entsteht. Ausgenommen hiervon ist nur ein zentraler Chipbereich **62**, der die Chips **12** und **14** aufnimmt. Auch wenn dieser kreisförmige Bereich in [Fig. 5](#) recht großzügig dargestellt ist, versteht es sich, dass anstelle dessen auch eine engere Heranführung der Printplatte an die Chips günstig sein kann.

**[0080]** Wie aus [Fig. 5](#) ersichtlich ist, erstrecken sich die Leiterbahnen **47** von Anschlußflächen **70**, **72** für Bonddrähte **74**, **76** nach außen, also zum Außenumfang des Basiskörpers **22** und sind dort über Anschlußdrähte **78**, **80** verbunden.

**[0081]** Der Abstandshalter **42** für die Abdecklinse **40** erstreckt sich kreisringförmig (vgl. [Fig. 5](#)), wobei die Abdecklinse **40** wiederum in einer Innenschulter **44** aufgenommen ist. Zwischen der planen Rückseite der Abdecklinse **40** und dem Chipbereich ist ein Raum **82** geschlossen ausgebildet, der seitlich von dem ringförmigen Abstandshalter **42** begrenzt ist. Dieser Raum ist bevorzugt mit einer durchsichtigen Substanz wie Silikongel oder einer Vergussmasse, die gegebenenfalls Phosphorpartikel aufweisen kann.

**[0082]** Eine weiter modifizierte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Strahlungsquelle **10** ist aus [Fig. 6](#) ersichtlich. Gleiche Bezugszeichen weisen hier wie auch in den weiteren Figuren auf gleiche Teile hin. Diese Ausgestaltung zeichnet sich durch eine ebenfalls recht kompakte Ausführung aus, bei der die LED-Chips kreuz- oder sternförmig angeordnet sind, wobei sich zwischen den äußeren LED-Chips **14** und **20** und der optischen Achse **60** nichts chipfremdes – außer gegebenenfalls einem sehr kompakten Reflektorelement **24** – erstreckt. Die Reflektorelemente **24** sind wiederum dachförmig ausgebildet, so dass sie Reflexionsflächen **26** und **28** bieten und das seitlich austretende Licht nach vorne werfen.

**[0083]** Aus [Fig. 7](#), aber auch aus [Fig. 6](#) ist ersichtlich, dass an die Leiterbahnen **47** je ein Vorwiderstand **84** angeschlossen ist, der gerade auch bei Parallelschaltung der LED-Chips dem Abgleich dienen kann. Dies ist besser aus [Fig. 7](#) ersichtlich, wobei

**Fig. 7** insgesamt vier je über Laserabgleich abgegliche Vorwiderstände **84** zeigt, die den vier äußeren LED-Chips **14** bis **12** zugeordnet sind. Bei dieser Lösung ist es vorgesehen, den Zentral-LED-Chip **12** mit einer anderen Wellenlänge und unabhängig zu betreiben, während die äußeren LED-Chips **14** bis **20** je parallel geschaltet sind und daher Vorwiderstände in ihren Leiterbahnen **47** aufweisen.

**[0084]** Die Printplatte **46** ist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel mit Durchkontaktierungen **90** versehen, die es erlauben, die Anschlußfahnen **92** von oben und von unten zu kontaktieren.

**[0085]** Wie aus **Fig. 7** ersichtlich ist, erstrecken sich Anschlußflächen, beispielsweise die Anschlußflächen **70** und **72** von außen neben die äußeren LED-Chips **14** bis **20**, während der Chipbereich **76** nach innen, also zur optischen Achse hin, frei von Leiterbahnen verbleibt.

**[0086]** Diese Lösung erlaubt es, trotz kompakter Anordnung die Leiterbahnen innerhalb des Abstandshalter **42** enden zu lassen, so dass Bonddrähte geschützt zu den Chips verlaufen können, aber dennoch eine gemeinsame Abdecklinse **40** – die aus **Fig. 7** nicht ersichtlich ist – sich oberhalb aller Chips **12** bis **20** erstrecken kann.

**[0087]** Eine weitere Ausführungsform ist aus **Fig. 8** und **Fig. 9** ersichtlich. Dort wie auch in den weiteren Figuren weisen gleiche oder ähnliche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche Teil hin. Bei dieser Lösung sind wiederum fünf LED-Chips **12** bis **20** im Wesentlichen kreuzförmig angeordnet, so dass die Chips **14** bis **20** einen zentralen Chip **12** umgeben. Die Chips sind je von Reflektorelementen **24** umgeben, die sich zwischen und neben ihnen erstrecken und Teil eines Abstandshalter bilden, der einen Reflektor **50** vor dem LED-Chips abstützt.

**[0088]** In der Zeichnungsebene unterhalb des Reflektors **50** und wie es besser aus **Fig. 9** ersichtlich ist, sind Strahlungsabsorber **24** und **96** vorgesehen, die sich zwischen den äußeren LED-Chips **14** und **20** einerseits und der Printplatte **46** erstrecken. Diese Lösung ist besonders günstig wenn es gilt, hochenergiereiche Strahlung abzufangen, ohne die Printplatte zu beeinträchtigen. Die Strahlungsabsorber **94** und **96** können als massive Körper auf dem Basiskörper **22** aufgebracht sein, beispielsweise über eine extrem dünne Klebeschicht, ähnlich wie auch die Chips selbst, so dass eine gute Wärmeableitung gewährleistet ist.

**[0089]** Die Strahlungsabsorber **94** und **96**, von denen natürlich bei den weiteren LED-Chips **16** und **18** ebenfalls zwei entsprechende Strahlungsabsorber vorgesehen sind, können aus beliebigen geeigneten Material bestehen. In Frage kommen beispielsweise

Kunststoffkörper, Aluminiumkörper, aber auch bevorzugt Keramikkörper, die auch dunkel eingefärbt sein können, um noch eine bessere Strahlungsabsorption zu gewährleisten.

**[0090]** In dem in **Fig. 8** dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Printplatte **46** zudem von einem Schutzring **98** abgedeckt, der ebenfalls dem besseren Schutz, insbesondere der Kalibrierwiderstände dient, denn durch eine zu starke Erwärmung der Kalibrierwiderstände kann die Kalibrierung beeinträchtigt werden.

**[0091]** Es versteht sich, dass der Schutzring **98** so dimensioniert ist, dass die Anschlussbahnen **92** frei bleiben, wobei der Schutzring bevorzugt mindestens auf seiner Unterseite elektrisch isolierend ausgestaltet ist.

**[0092]** Aus **Fig. 9** ist ersichtlich, dass die LED-Chips **14**, **12** und **20** je auch von dem Reflektorelement beabstandet angeordnet sind. Auch dies trägt dazu bei, die intensive Wärmeabgabe durch die LED-Chips nicht zu einer intensiven Wärmebeaufschlagung des Gitterreflektors **30**, der aus Kunststoff mit verspiegelten Oberflächen bestehen kann, werden zu lassen.

**[0093]** Auch wenn bei der Darstellung gemäß **Fig. 9** keine Linse entsprechend der Abdecklinse **40** dargestellt ist, versteht es sich, dass diese in beliebiger geeigneter Weise dort vorgesehen sein kann.

## Patentansprüche

1. Halbleiter-Strahlungsquelle, mit einem Basiskörper, auf dem mindestens zwei LED-Chips unmittelbar gelagert und in Wärmeleitverbindung auf dem Basiskörper angebracht sind, wobei mindestens eine Printplatte (**46**) auf dem Basiskörper gelagert ist, die sich von den zentral angeordneten LED-Chips (**12**, **14**, **16**, **18**, **20**) nach außen, insbesondere zum Umfangsbereich des Basiskörpers (**22**), erstreckt.

2. Strahlungsquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Printplatte (**46**) in Freiflächen hineinragt, die sich seitlich neben den Chips (**12**, **14**, **16**, **18**, **20**) erstrecken.

3. Strahlungsquelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Printplatte (**46**) bis neben die Chips (**12**, **14**, **16**, **18**, **20**) verläuft, jedoch nicht zwischen Chips (**12**, **14**, **16**, **18**, **20**) und optischer Achse (**60**) der Strahlungsquelle.

4. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster LED-Chip (**12**) in einer optischen Achse (**60**) angeordnet ist und eine Mehrzahl von mehreren LED-Chips (**14**, **16**, **18**, **20**), insbesondere symmetrisch zueinander und den LED-Chip (**12**) nach der Art

eines Kreuzes oder Sternes umgebend, radial außerhalb des ersten LED-Chips (12) angeordnet sind.

5. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vier weitere LED-Chips (14, 16, 18, 20) den ersten LED-Chip (12) umgeben.

6. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) in dem zentralen Bereich des Basiskörpers (22) einander benachbart, also ohne Printplatte (46) zwischen ihnen, angeordnet sind.

7. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Printplatte (46) die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) umgibt.

8. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) und die Printplatte (46) im Wesentlichen die gleiche Höhe aufweisen.

9. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere über Bondverbindungen Anschlußflächen (70, 72) von Leiterbahnen (47) der Printplatte (46) mit den LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) verbunden sind.

10. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20), ggf. über einen thermisch leitfähigen Kleber, unmittelbar auf dem Basiskörper (22) gelagert sind und die Printplatte (46) auf dem Basiskörper (22) insbesondere aufgeklebt ist.

11. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Printplatte (46) eine Epoxidharzbasis aufweist und wenigstens auf einer Seite mindestens eine Leiterbahn (47) aufweist und insbesondere mit Kupfer beschichtet sowie durchkontaktiert ist.

12. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) auf einem zentralen Vorsprung des Basiskörpers (22) angeordnet sind, dessen Höhe im Wesentlichen der Höhe der Printplatte (46) entspricht.

13. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwischen zwei einander benachbarten LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) ein Reflektorelement (24) angeordnet ist, das sich an dem Basiskörper (22), und/oder der Printplatte (46) und/oder den

LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20), insbesondere auch an dem Basiskörper (22), abstützt.

14. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein sich zwischen zwei LED-Chips erstreckendes Reflektorelement (24) zwei im Wesentlichen schräg verlaufende Reflexionsflächen (26, 28) aufweist, wobei jede Reflexionsfläche aus dem benachbarten LED-Chip stammende Strahlung reflektiert.

15. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reflexionsflächen (26, 28) in Richtung der optischen Achse (60) betrachtet sich im Wesentlichen entsprechend der Höhe der Printplatte (22) erstrecken oder die Printplatte (22) überragen.

16. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Reflexionsflächen (26, 28) leicht konkav oder parabolisch ausgestaltet sind und dass das Reflektorelement (24) einen im Wesentlichen dreieckigen Querschnitt, insbesondere im Wesentlichen eines gleichschenkligen Dreiecks, aufweist.

17. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Reflektorelemente (24) unter Bildung eines Gitterreflektors (30) miteinander verbunden sind.

18. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) in dem Gitterreflektor (30) aufgenommen sind und dass sich der Gitterreflektor an dem Basiskörper (22) und/oder der Printplatte (46) und/oder den LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) abstützt.

19. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich Reflektorelemente (24) zwischen den seitlichen Freiflächen (34, 36) und den LED-Chips erstrecken und dort insbesondere die LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20) abstützen.

20. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen LED-Chips (12, 14, 16, 18, 20), insbesondere zwischen äußeren LED-Chips (14, 16, 18, 20), und der Printplatte (46) Strahlungsabsorber erstrecken, die insbesondere mit dem Basiskörper (22) in Wärmeleitverbindungen miteinander verbunden sind.

21. Strahlungsquelle nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsabsorber zugleich wärmedämmend ausgebildet sind und insbesondere aus Keramik bestehen.

22. Strahlungsquelle nach einem der Ansprüche 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsabsorber sich mindestens über die Breite der LED-Chips (**14, 16, 18, 20**) erstrecken und insbesondere eine größere Höhe als die LED-Chips (**14, 16, 18, 20**) aufweisen, bevorzugt etwa die 1,5 bis 5-fache Höhe und besonders bevorzugt etwa die zweifache Höhe der LED-Chips (**14, 16, 18, 20**).

23. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Abdecklinse (**40**) im Strahlengang nach den LED-Chips (**12, 14, 16, 18, 20**) angeordnet ist und ein Abstandshalter (**42**) für diese im Wesentlichen rohr- oder ringförmig ausgebildet ist, und dass der Abstandshalter (**42**) mindestens teilweise auf der Printplatte (**46**) und/oder dem Basiskörper (**22**) abgestützt ist.

24. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Leiterbahn der Printplatte (**46**) unter einem Abstandshalter (**42**) hindurch verläuft und insbesondere von außerhalb des Abstandshalters (**42**) nach innerhalb des Abstandshalters verläuft.

25. Strahlungsquelle nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen den LED-Chips (**12, 14, 16, 18, 20**), dem Abstandshalter (**42**) und der Abdecklinse (**40**) ein geschlossener Raum (**82**) erstreckt, der eine durchsichtige oder durchscheinende, flüssige oder gelförmige Substanz, insbesondere Silikon gel oder eine Vergußmasse, aufweist.

26. Strahlungsquelle nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz Phosphorpartikel aufweist.

27. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Strahlengang nach einer Abdecklinse (**40**) eine Sammellinse (**52**) angeordnet ist, deren Durchmesser insbesondere größer als der Durchmesser der Abdecklinse (**40**) ist.

28. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von den LED-Chips (**12, 14, 16, 18, 20**) beabstandet vor diesen, also im Strahlengang nach diesen, und/oder insbesondere auch im Strahlengang nach einer Abdecklinse (**40**), ein Reflektor (**50**) angeordnet ist.

29. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Strahlengang nach dem Reflektor (**50**) ein Lichtleiter angeordnet ist.

30. Strahlungsquelle nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Printplatte (**46**), außerhalb des Abstandshalters (**42**) insbesondere abgleichbare Vorwiderstände (**84**) angeordnet sind, die für die Abgleichung freizugänglich sind.

31. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste LED-Chip (**12**) und die weiteren LED-Chips (**14, 16, 18, 20**) Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen ausstrahlen, insbesondere einerseits mit 400 bis 430 nm und andererseits mit 450 bis 480 nm.

32. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Chip (**12**) und die weiteren Chips (**14, 16, 18, 20**) gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten einschaltbar und ausschaltbar sind.

33. Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste LED-Chip (**12**) Licht mit 400 bis 430 nm und die weiteren LED-Chips (**14, 16, 18, 20**) Licht mit 450 bis 480 nm ausstrahlen.

34. Lichthärtgerät mit wenigstens einer Halbleiter-Strahlungsquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere zum Aushärten von lichtpolymerisierbaren Dentalmassen.

35. Lichthärtgerät nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass es als Handgerät mit einem Griff ausgebildet ist.

36. Lichthärtgerät nach Anspruch 32 oder Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass das Lichthärtgerät ein Gehäuse (**54**) aufweist, an dem die Sammellinse (**52**) abgestützt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

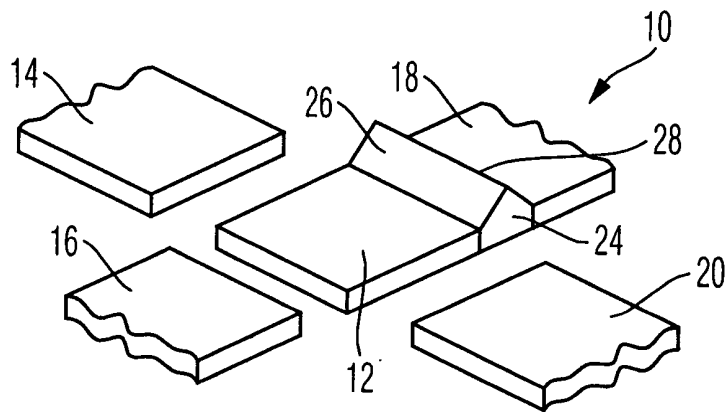


Fig. 1

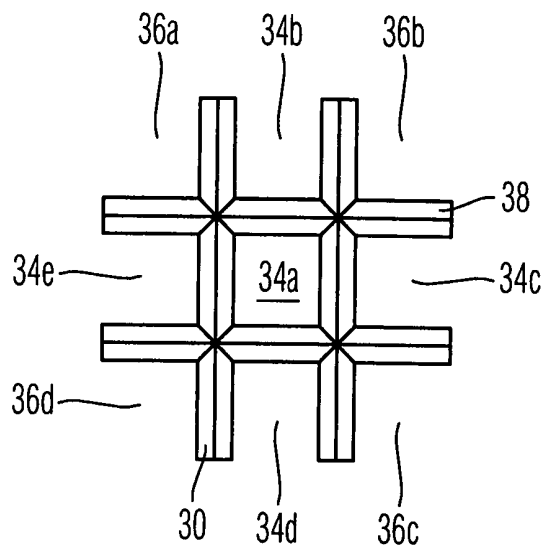


Fig. 2

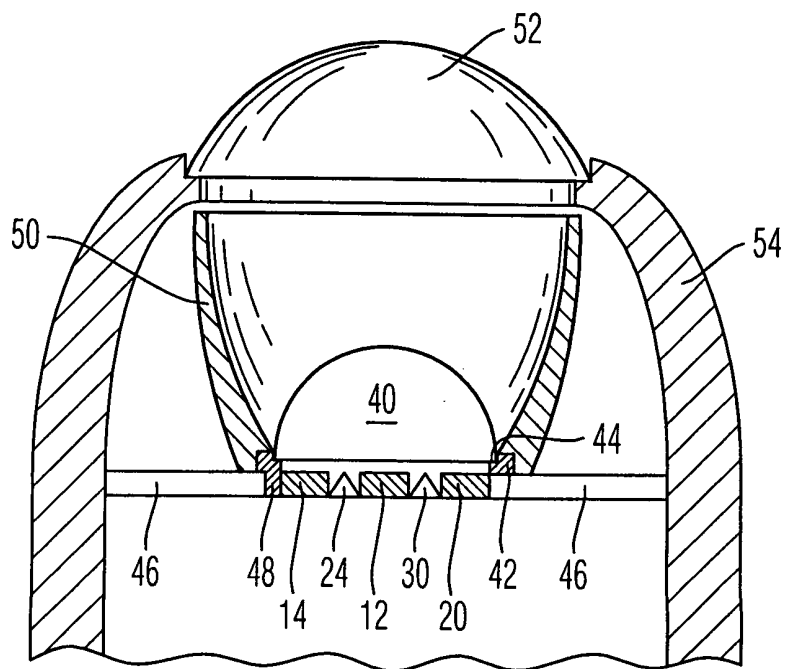


Fig. 3

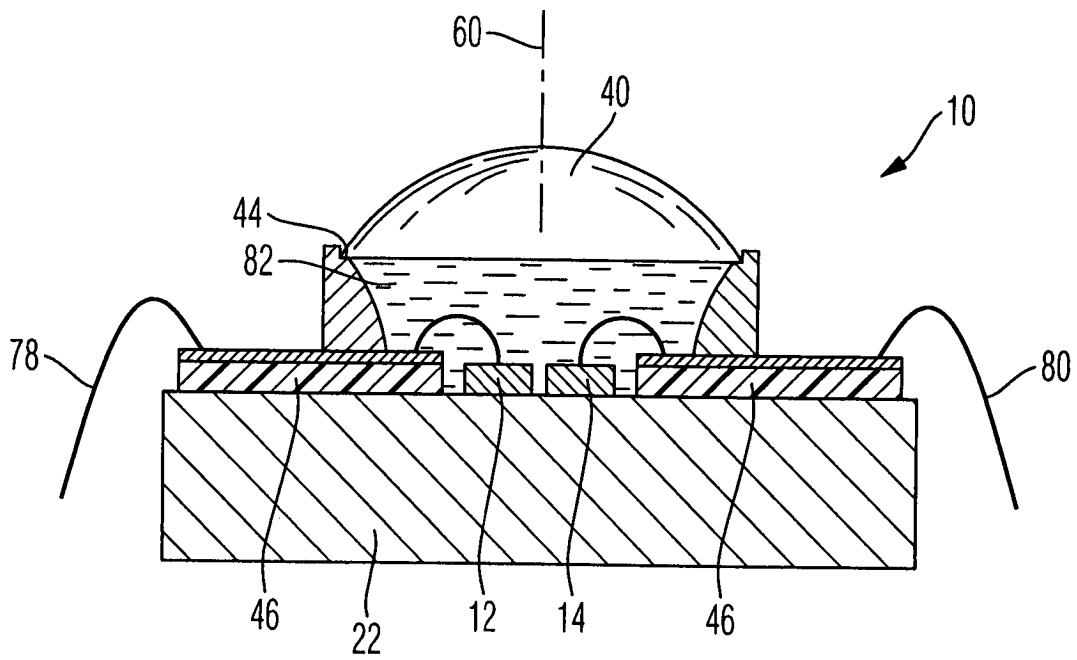


Fig. 4

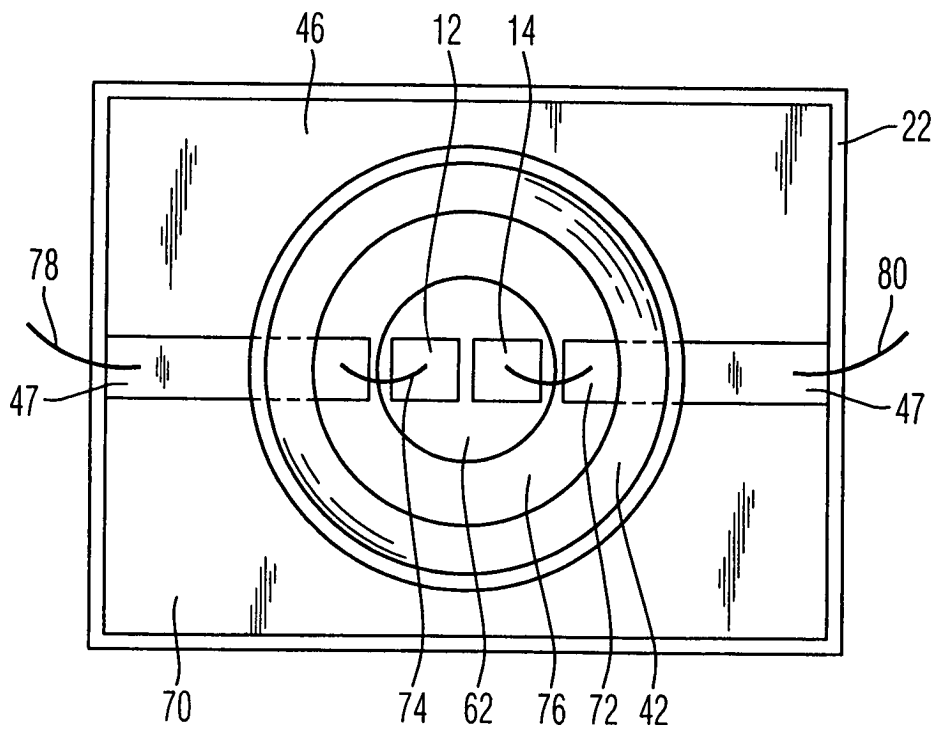


Fig. 5

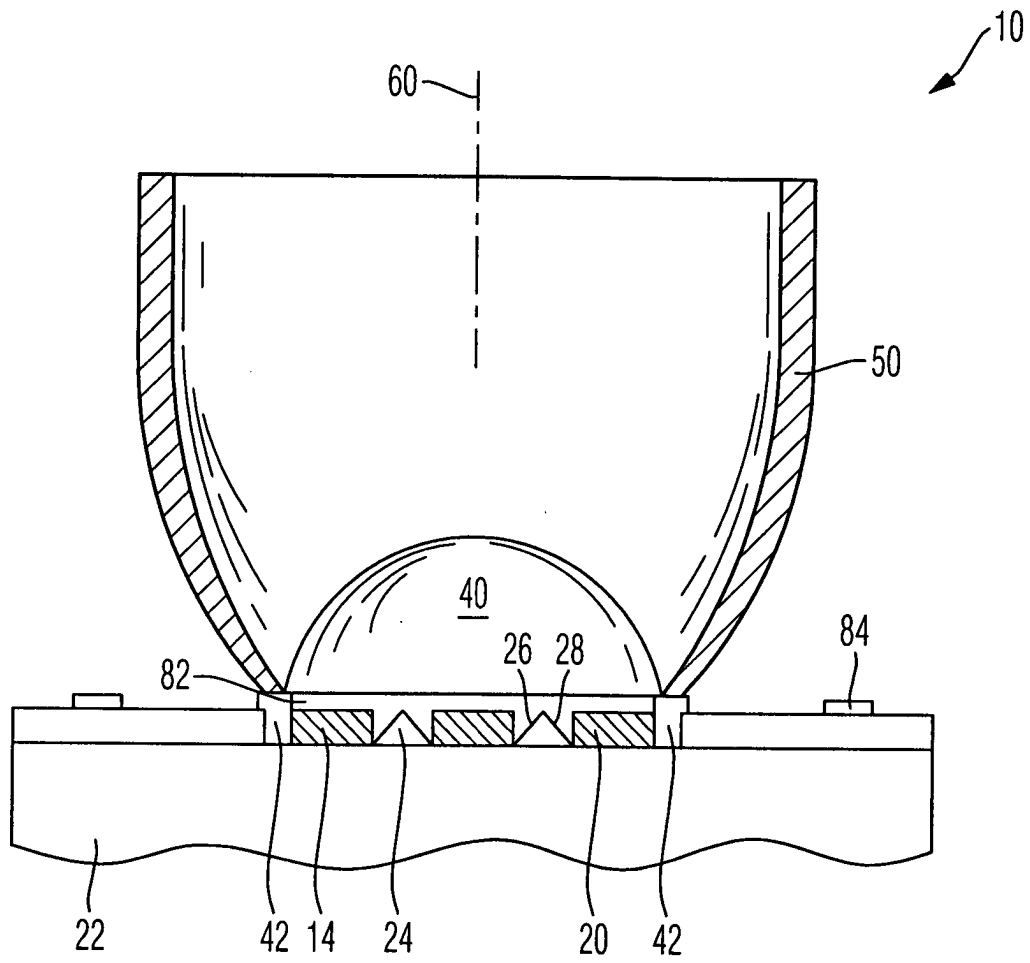


Fig. 6

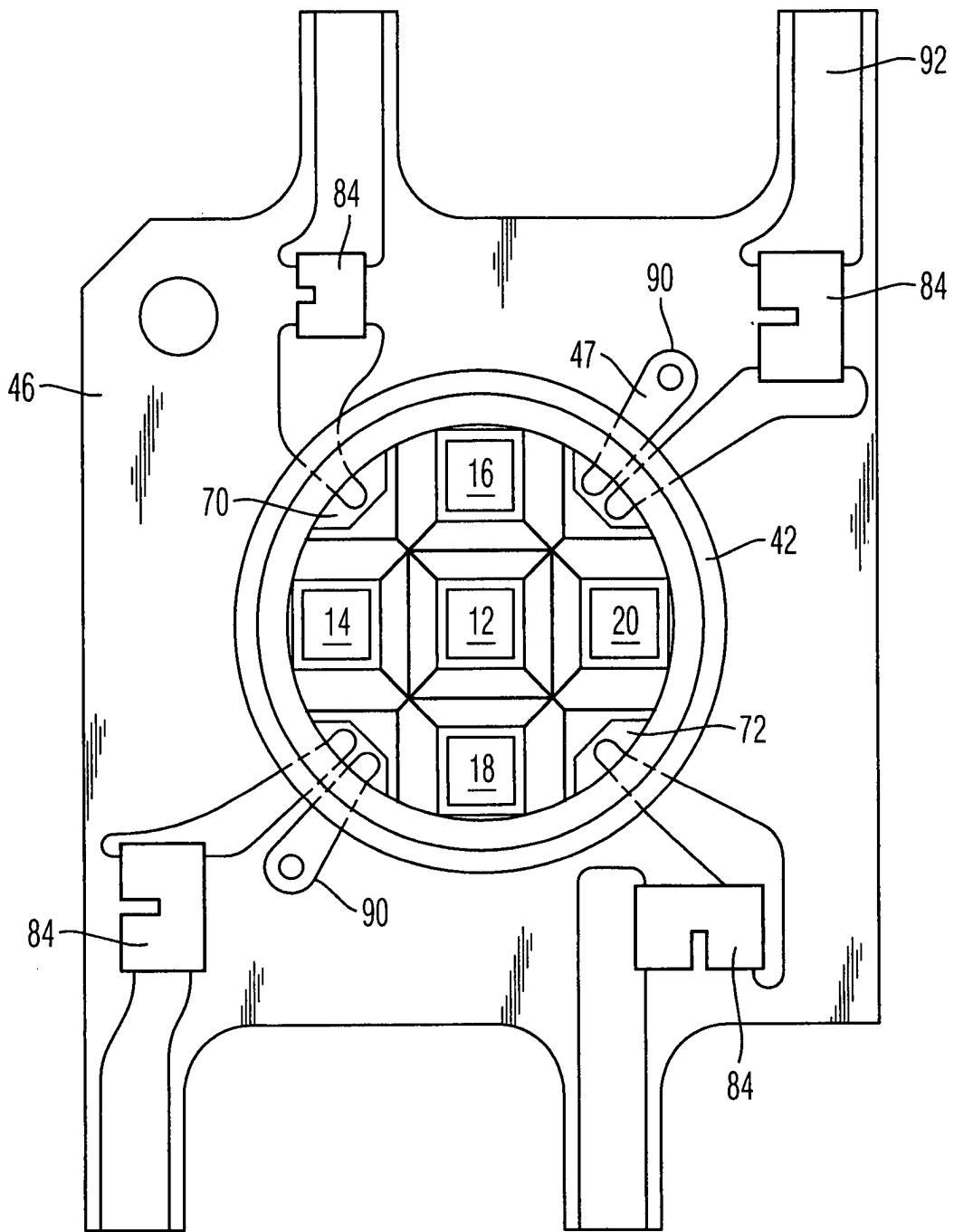


Fig. 7

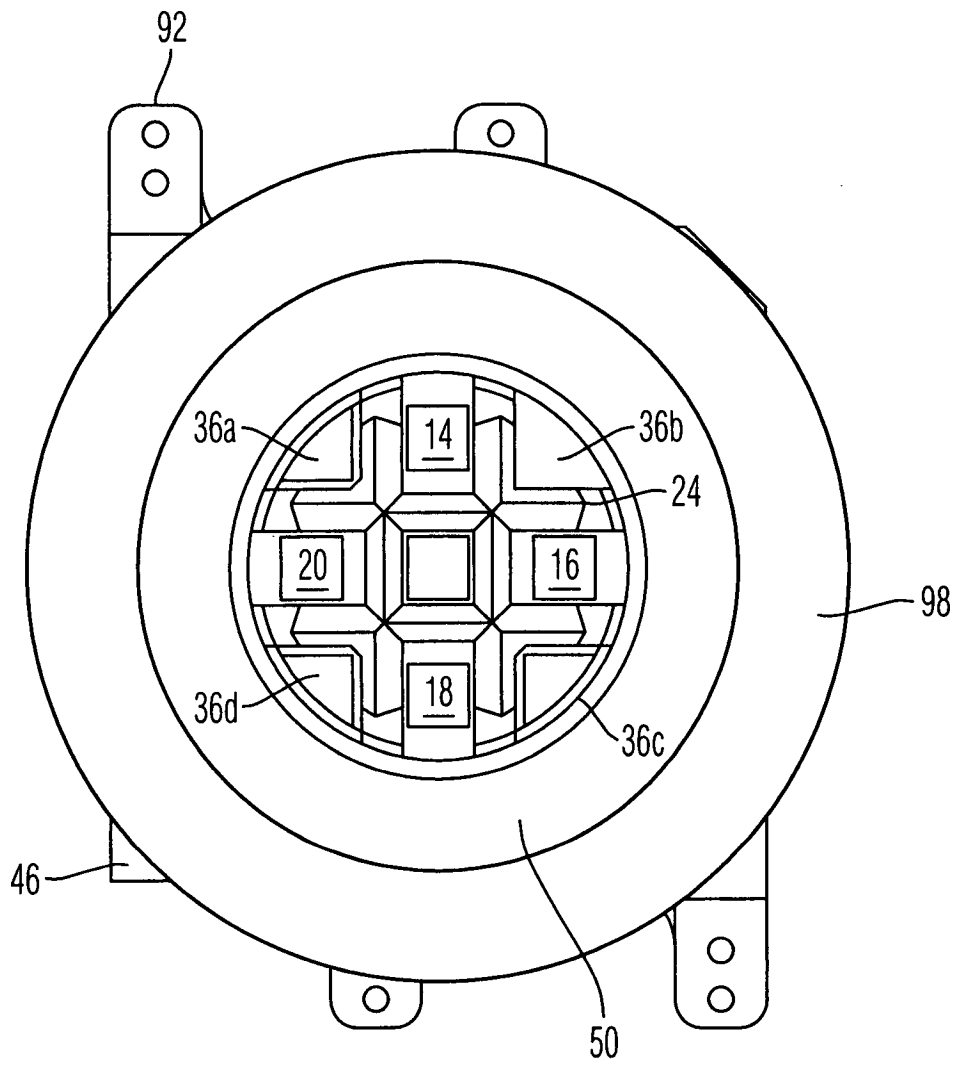


Fig. 8

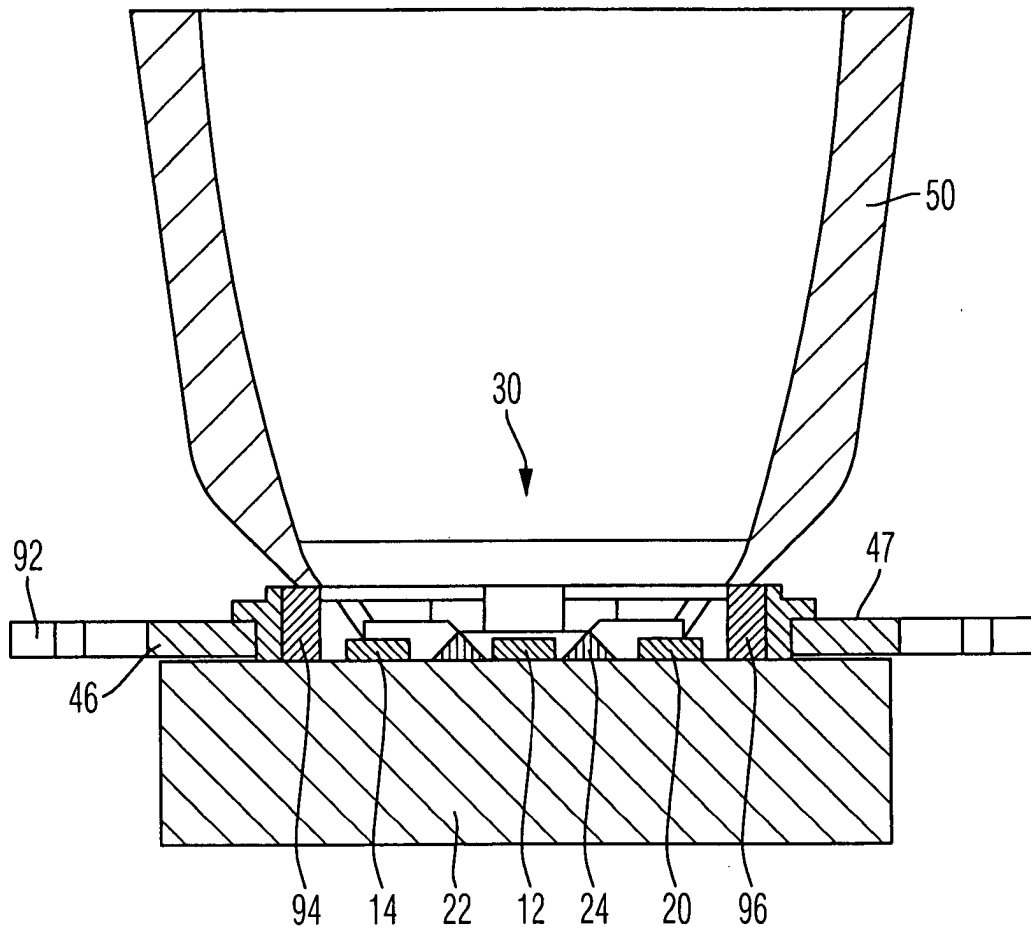


Fig. 9